


安全评价报告信息公开表

被评价单位名称	奥芯半导体科技（浙江）有限公司
评价项目名称/项目编号	年产 14400 万颗 IC 封装基板项目安全预评价报告/天为（评）字 23-11-14 号
项目简介 (含图片)	<p>奥芯半导体科技（浙江）有限公司成立于 2023 年 7 月 7 日，位于浙江省安吉经济开发区两山高新技术产业园电子信息园区栗山路北侧，注册资本：10416.6666 万元整。法定代表人：陶子鹏。经营范围：一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路设计；集成电路销售；集成电路制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司为适应市场形势，企业拟新征用地 97.22 亩，新建生产厂房、仓库、研发楼、废水处理站及其他辅助构筑物合计建筑面积 135098.13 平方米，购置发料烘烤、发料减铜线、机钻等生产设备辅助设备，建成达产后，可形成年产 14400 万颗 IC 封装基板的生产能力。选址位于安吉经济开发区两山高新技术产业园电子信息园区栗山路北侧。企业于 2023 年 9 月 21 日取得了由安吉县经济和信息化局核发的浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，项目代码：2309-330523-07-01-925447。</p> <p>本项目产品 IC 封装基板不属于危险化学品，生产过程中不涉及危险化学品生产及溶剂回收，生产过程中涉及使用危险化学品：硼酸（98%）、乙醇[无水]、混合气体 1（氧-氩比 1：9）、异丙醇、氢氧化钠溶液（30%、32%）、氰化亚金钾、六水合氯化镍、混合气体 2（0.15%H₂、5%CO、14%CO₂、18%N₂、62.85%He）、硫酸（50%）、双氧水（35%）、SPS（35%过硫酸钠）、盐酸（32%）、柴油（燃料）、氮、除胶渣剂 PM（40%高锰酸钠溶液）、中和剂 PFH、整孔剂 950H、化学铜还原剂、清洁液 ST-250T、超粗化微蚀液 CS-1602M、超粗化微蚀液 CS-1602R、氯化铜蚀刻母液、铜面微蚀清洁剂 CA-5342H-L、铜面抗氧化剂 CL-8300、促进剂 7820A、中和剂 7831R、酸性除油剂 H、微蚀盐 H。根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，第 645 号修订）、《危险化学品安全使用许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 57 号，总局令第 89 号修订），本项目属于集成电路制造（3973），未列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录》（2013 年版），且使用的危险化学品未达到《危险化学品使用量的数量标准》（2013 年版）内的临界值，因此不需要领取危险化学品使用许可证。</p> 
安全评价机构名称	浙江天为安全科技有限公司编制

项目组长		刘义梅
技术负责人		相继园
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		刘义梅
报告审核人		王铁军
参与评价工作	安全评价师	阮佳、邵东卫、刘义梅、王骥、卜伟华
	注册安全工程师	邵东卫、刘义梅、王骥
	技术专家	
现场开展安全评价工作	人员	刘义梅、邵东卫
	时间	2025.07.29
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2025.12